



连接器 > 连接器附件 > 连接器硬件



硬件附件功能: **导轨硬件**

连接器硬件附件类型: **导套模块**

工作温度 (最大值): 105 °C [221 °F]

工作温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

产品特性

产品类型特性

硬件附件功能	导轨硬件
连接器硬件附件类型	导套模块

结构特性

附件放置位置	前板
--------	----

主体特性

产品方向	直角
------	----

尺寸

产品长度	31.88 mm[1.255 in]
------	--------------------

使用环境

工作温度 (最大值)	105 °C[221 °F]
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)

SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月
(240)
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





文档

产品图纸

[MGIG HSG KEY/ESD .8" 315 DEG](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1410546-8_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1410546-8_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1410546-8_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[2_PIECE_POWER_CONNECTORS_qrg_4-1773458-1](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本